【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成22年11月25日(2010.11.25)

【公表番号】特表2008-522139(P2008-522139A)
【公表日】平成20年6月26日(2008.6.26)
【年通号数】公開・登録公報2008-025
【出願番号】特願2007-541701(P2007-541701)
【国際特許分類】
Ｇ０１Ｎ　27/00　　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｇ０１Ｎ　27/00　　Ｊ

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年10月8日(2010.10.8)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】請求項１５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【請求項１５】
前記第１の導体路層が、アルミニウムからなり、前記第２の導体路層が、ポリシリコンからなることを特徴とする請求項１ないし１３いずれか１項に記載の電気的構成部材(1)。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
第１の導体路層が金属から、好ましくはアルミニウムからなり、第２の導体路層がドープされた半導体材料から、特にポリシリコンからなると、効果的である。アルミニウムからなる導体路は、良好な電気的導通性を有している。アルミニウムは、比較的わずかな腐食耐性しか持たないので、表面近傍の第１の導体路層は、インタラクション面によって覆われるチップ領域の外部のみに、かつこの領域に対して間隔をおいて設けられている。インタラクション面によって覆われるチップ領域の内部では、導体路ガイドのためにポリシリコンからなる１つ又は複数の導体路層のみが使用される。それによってチップは、開口部内にある液状又はペースト状の媒体に対して更に良好な腐食耐性を有する。インタラクション面によって覆われるチップ領域の外部において、ポリシリコン導体路をアルミニウム導体路と接続することができる。第１の導体路層と第２の導体路層の間に、場合によっては、金属からなる少なくとも１つの他の導体路層とそれに対応づけられた他の絶縁層を配置することができ、即ち第２の導体路層がセンサチップの、必ずしも上から２番目の導体路層である必要はなく、第２の絶縁層が必ずしも上から２番目の絶縁層である必要はない。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】

第２の絶縁層１６と電界酸化物層９の間に、酸化物層として形成された第３の電気的絶縁層２０が配置されている。この第３の絶縁層と第２の絶縁層１６の間に、領域的に、ポリシリコン層からなり、かつ導体路を形成する、第３の導体路層２１が設けられている。第３の絶縁層２０と電界酸化物層９の間に、同様にポリシリコン層２２からなり、かつ他の電気的導体路を有する、第４の導体路層２２が配置されている。